

29.09.2004

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日                      2 0 0 3 年    9 月 3 0 日  
Date of Application:

出 願 番 号                      特 願 2 0 0 3 - 3 4 1 0 1 6  
Application Number:  
[ST. 10/C] :                      [ J P . 2 0 0 3 - 3 4 1 0 1 6 ]

出      願      人                      東芝マテリアル株式会社  
Applicant(s):                      株式会社東芝

REC'D 02 DEC 2004

WIPO                      PCT

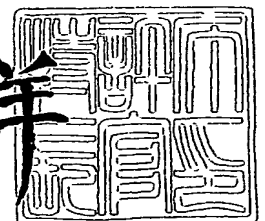
PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 1 1 月 1 8 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川

洋



【書類名】 特許願  
【整理番号】 9FB0320321  
【提出日】 平成15年 9月30日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H01L 33/00  
【発明者】  
    【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝 横浜事業  
                                所内  
    【氏名】 矢野 圭一  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000003078  
    【氏名又は名称】 株式会社 東芝  
【代理人】  
    【識別番号】 100078765  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 波多野 久  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100078802  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 関口 俊三  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100077757  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 猿渡 章雄  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100122253  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 古川 潤一  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 011899  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 図面 1  
    【物件名】 要約書 1

## 【書類名】特許請求の範囲

## 【請求項 1】

窒化アルミニウムから成る同時焼成基板の表面に発光素子が搭載された発光装置であり、上記窒化アルミニウム基板の発光素子が搭載される表面が  $0.3 \mu\text{mRa}$  以下の表面粗さを有するように鏡面研磨されているとともに、上記発光素子の周囲となる窒化アルミニウム基板表面に、発光素子からの発光の反射率が 90% 以上である金属蒸着膜が形成されている一方、上記発光素子が搭載される窒化アルミニウム基板の表面と裏面とを貫通し発光素子に裏面から導通させるためのビアホールが形成されていることを特徴とする発光装置。

## 【請求項 2】

請求項 1 記載の発光装置において、前記金属蒸着膜がアルミニウムまたは銀から成ることを特徴とする発光装置。

## 【請求項 3】

請求項 1 記載の発光装置において、前記発光素子として LED チップが搭載されている他に逆電流防止用のダイオード、抵抗、サーミスタの少なくとも 1 種の周辺部品が窒化アルミニウム基板に搭載されていることを特徴とする発光装置。

## 【請求項 4】

請求項 1 記載の発光装置において、前記発光素子が搭載される窒化アルミニウム基板の表面粗さが  $0.1 \mu\text{mRa}$  以下であることを特徴とする発光装置。

## 【請求項 5】

請求項 1 記載の発光装置において、前記発光素子が、フリップチップ法により窒化アルミニウム基板に実装されていることを特徴とする発光装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】発光装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、発光ダイオード（LED: Light Emitting Diode）等の発光素子を絶縁基板表面に搭載した発光装置に係り、特に小型に形成することが可能であり、また放熱性が優れ、より大きな電流を流すことができ、発光効率が高く輝度を大幅に増加させることが可能な発光装置に関する。

【背景技術】

【0002】

発光ダイオード（以下、LEDチップともいう。）は、電圧を印加すると光源として作用する発光素子であり、二つの半導体の接触面（pn接合）付近での電子と正孔との再結合によって発光する光を利用する発光素子である。この発光素子は小型で電気エネルギーの光への変換効率が高いため、家電製品や照光式操作スイッチ、LED表示器として広く用いられている。

【0003】

また、フィラメントを用いる電球とは異なり、半導体素子であるために球切れがなく、初期駆動特性に優れ、振動や繰り返しのON/OFF操作にも優れた耐久性を有するため、自動車用ダッシュボードなどの表示装置のバックライトとしても用いられる。特に、太陽光に影響されずに高彩度で鮮やかな色の発光が得られるため、屋外に設置される表示装置、交通用表示装置や信号機等にも、今後その用途が拡大される状況である。

【0004】

上記のLEDチップのような発光素子を搭載した従来の発光装置としては、例えば図4に示す発光装置が提案されている（例えば、特許文献1参照。）。この発光装置1は導体配線2を内部に配し凹状開口部を有するセラミックスパッケージ3と、この凹状開口部内においてボンディングワイヤ4を介して上記導体配線2と電気的に接続された発光素子としてのLEDチップ5と、上記凹状開口部側壁に形成された第1の金属層6および第2の金属層7と、上記凹状開口部を封止する樹脂モールド8とを備えて構成されている。

【0005】

上記従来の発光装置によれば、凹状開口部内に設けた第1の金属層6によってセラミックスパッケージ3との密着性が高まると共に、LEDチップ5からの光が第2の金属層7によって反射され、光損失を低減でき、ディスプレイなどのコントラストの向上が可能とされている。

【特許文献1】特開平10-215001号公報（第1-3頁、図2）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかしながら、上記従来の発光装置においては、LEDチップを搭載したセラミックスパッケージがアルミナ（ $Al_2O_3$ ）を主体とする熱伝導率が低いセラミックス材で形成されており、またLEDチップを封止する樹脂モールドの熱伝導率も低かったために、放熱性が極めて悪い致命的な欠点があった。そのため、高電圧・高電流を印加すると、発熱によりLEDチップが破壊されてしまうことになる。したがって、LEDチップに印加できる電圧が低く、電流値も数十mA程度に制限されるため、発光輝度が低い問題点があった。

【0007】

なお従来のLEDチップを使用した発光装置では、要求される発光輝度も小さかったため、上記従来の発光装置における通電量でも実用上は大きな障害もなく用いられていた。しかしながら、近年においてLED発光装置の具体的な応用範囲が拡大されるにしたがって、より高出力で通電量が数A程度までに高めることが可能であり、発光輝度を大きくできる構造を実現することが技術上の課題となっている。

## 【0008】

また、図4に示すような従来の発光装置では、ワイヤボンディング法を使用してLEDチップと導体配線とを電氣的に接合していたために、ボンディングワイヤが立ち上がった部分が厚さ方向に突出することになり、またボンディングワイヤの端部を接続するための大きな電極領域が必要となるため、配線構造も含めたLEDパッケージが大型化する難点があった。

## 【0009】

さらに、上記ボンディングワイヤが厚さ方向に突出する影響を回避するために、図4に示すように、凹状開口部内にLEDチップを収容するように構成すると、LEDチップからの発光が凹状開口部内壁に吸収されて光の損失が増加して発光効率が低下してしまう問題点もあった。そのために、前記公知例では凹状開口部内壁に、光を反射する金属層を形成し光の吸収損失を低減している。しかしながら、曲面状の内壁を有する凹状開口部内に均一に反射用金属層を形成することは極めて困難であり、部分的に発光が内壁に吸収されて光の損失が生じることになり、また凹状開口部内壁自体が光の進行を妨げる構造であるために、発光輝度が低下する問題点があった。

## 【0010】

本発明は上記従来の問題点を解決するためになされたものであり、小型に形成することが可能であり、また放熱性が優れ、より大きな電流を流すことができ、発光効率が高く輝度を大幅に増加させることが可能な発光装置を提供することを目的とする。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0011】

上記目的を達成するために本発明は、窒化アルミニウムから成る同時焼成基板の表面に発光素子が搭載された発光装置であり、上記窒化アルミニウム基板の発光素子が搭載される表面が $0.3\mu\text{mRa}$ 以下の表面粗さを有するように鏡面研磨されているとともに、上記発光素子の周囲となる窒化アルミニウム基板表面に、発光素子からの発光の反射率が90%以上である金属蒸着膜が形成されている一方、上記発光素子が搭載される窒化アルミニウム基板の表面と裏面とを貫通し発光素子に裏面から導通させるためのビアホールが形成されていることを特徴とする。

## 【0012】

また、上記発光装置において、前記金属蒸着膜がアルミニウムまたは銀から成ることが好ましい。さらに、前記発光素子としてLEDチップが搭載されている他に逆電流防止用のダイオード、抵抗、サーミスタの少なくとも1種の周辺部品が窒化アルミニウム基板に搭載されていることが好ましい。

## 【0013】

また、上記発光装置において、前記発光素子が搭載される窒化アルミニウム基板の表面粗さが $0.1\mu\text{mRa}$ 以下であることが、さらに好ましい。

## 【0014】

さらに、上記発光装置において、前記発光素子が、フリップチップ法により窒化アルミニウム基板に実装されていることが好ましい。

## 【0015】

すなわち、本発明に係る発光装置においては、LEDチップを搭載するセラミックス基板(LED用パッケージ)として、熱伝導率が高い窒化アルミニウム(AlN)のコファイア基板(同時焼成基板)を使用する。特に、熱伝導率が高い窒化アルミニウム基板を使用しているため、発光装置の放熱性が大幅に高まり、通電限界量が増大し大電流を流すことが可能になるために、発光輝度を大幅に高くすることが可能になる。

## 【0016】

また、発光素子が搭載される基板表面が鏡面研磨されているために、研磨面での反射率が高くなり発光素子の接合面側からの発光が効果的に基板表面側に反射され、発光強度(輝度)を実質的に上昇させることができる。なお、鏡面研磨面の表面粗さは、日本工業規格(JIS B0601)で規定される算術平均粗さ(Ra)基準で $0.3\mu\text{mRa}$ 以下

とされる。この表面粗さが $0.3\mu\text{mRa}$ を超えるように粗くなると、上記研磨面での発光の乱反射や吸収が起こり易く、発光強度が低下し易くなる。そのため、上記鏡面研磨面の表面粗さは $0.3\mu\text{mRa}$ 以下とされるが、 $0.1\mu\text{mRa}$ 以下とすることにより、さらに発光の反射率を高めることができる。

#### 【0017】

さらに、発光素子の周囲となる窒化アルミニウム基板表面に、発光素子からの発光の反射率が90%以上である金属蒸着膜を形成することにより、発光素子の裏面側からの発光が効果的に金属蒸着膜によって反射され基板表面側に反転されるため、基板表面側への発光強度（輝度）をさらに高めることができる。なお、反射率が90%以上である金属蒸着膜としては、アルミニウムまたは銀から構成することが好ましい。この金属蒸着膜は化学的蒸着法（CVD法）やスパッタリング法によって、厚さが $1\sim 5\mu\text{m}$ 程度となるように形成する。なお、上記反射率は、入射光の発光強度に対する反射光の発光強度の比で与えられる。

#### 【0018】

また、発光素子が搭載される窒化アルミニウム基板の表面と裏面とを貫通し発光素子に裏面から導通させるためのビアホールが形成されているため、発光素子への通電は窒化アルミニウム基板の裏面からこのビアホールを介して表面側の発光素子になされる。そのため、基板の表面側においてワイヤボンディング法によって配線を接続する必要がなく、配線構造が簡素化される上に、ボンディングワイヤの厚さ方向への突出がないため、発光装置を薄く小型に形成できる。

#### 【0019】

さらに、窒化アルミニウム基板に、発光素子としてLEDチップを搭載する他に逆電流防止用のダイオード、抵抗、サーミスタの少なくとも1種の周辺部品を搭載するように構成することにより、基板表面における部品実装密度を高めることも可能であり、発光装置を、より小型に形成できる。

#### 【0020】

また、上記発光装置において、発光素子が搭載される窒化アルミニウム基板の表面と裏面とを貫通し発光素子に裏面から導通させるためのビアホールが形成されているため、発光素子をフリップチップ法により窒化アルミニウム基板に実装することが可能になる。すなわち、LEDチップなどの発光素子の接続端部にソルダバンプなどの金属バンプを形成し、このバンプをビアホールおよび配線導体端部に設けたランドを介して、基板の裏面に配置した通電配線と接続するフェイスダウン方式による配線が可能になる。このフェイスダウン方式による配線構造によれば、発光素子表面の任意の位置から電極を取り出すことが可能であるため、発光素子と配線導体とが最短距離で接続可能である上に、電極数が増加しても発光素子としてのLEDチップのサイズが大型化せず、しかも超薄型実装も可能になる。

#### 【発明の効果】

##### 【0021】

上記構成に係る発光装置によれば、LEDチップを搭載する基板（LED用パッケージ）として、熱伝導率が高い窒化アルミニウム（AlN）のコファイア基板（同時焼成基板）を使用しているため、発光装置の放熱性が大幅に高まり、通電限界量が増大し大電流を流すことが可能になるために、発光輝度を大幅に高くすることが可能になる。

##### 【0022】

また、発光素子が搭載される基板表面が鏡面研磨されているために、研磨面での反射率が高くなり発光素子の接合面側からの発光が効果的に基板表面側に反射され、発光強度（輝度）を実質的に上昇させることができる。

##### 【0023】

さらに、発光素子が搭載される窒化アルミニウム基板の表面と裏面とを貫通し発光素子に裏面から導通させるためのビアホールが形成され、発光素子への通電は窒化アルミニウム基板の裏面からこのビアホールを介して表面側の発光素子になされるため、基板の表面

側においてワイヤボンディング法によって配線を接続する必要がなく、配線構造が簡素化される上に、ボンディングワイヤの厚さ方向への突出がないため、発光装置を薄く小型に形成できる。

#### 【0024】

また、窒化アルミニウム基板の表面と裏面とを貫通し発光素子に裏面から導通させるためのビアホールが形成されているため、発光素子をフリップチップ法によりフェイスダウン方式による配線が可能になる。このフェイスダウン方式による配線構造によれば、発光素子表面の任意の位置から電極を取り出すことが可能であるため、発光素子と配線導体とが最短距離で接続可能である上に、電極数が増加しても発光素子としてのLEDチップのサイズが大型化せず、しかも超薄型実装も可能になる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0025】

次に本発明に係る発光装置の実施形態について添付図面を参照してより具体的に説明する。

#### 【0026】

##### [実施例1～6および比較例1～4]

各実施例用および比較例用の基板として、表1に示すような厚さおよび熱伝導率を有する窒化アルミニウム (AlN) 基板、エポキシ樹脂基板およびアルミナ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 基板を多数用意した。各実施例用の窒化アルミニウム (AlN) 基板および比較例用のアルミナ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 基板は、同時焼成法によって製造されたものであり、基板の厚さ方向に貫通するビアホールが形成されていると共に、ビアホールの基板裏面側の端部には部品のリードを接合するための端子導体部分としてのランドが形成されている。

#### 【0027】

次に、窒化アルミニウム (AlN) 基板およびアルミナ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 基板の発光素子としてのLEDチップが搭載される表面が表1に示すように0.1～0.3 μm Raの表面粗さを有するように鏡面研磨した。さらに、発光素子としてのLEDチップの周囲となる基板表面に、表1に示す厚さで銀 (Ag) またはアルミニウム (Al) から成る金属蒸着膜を化学蒸着法によって形成した。

#### 【0028】

なお、比較例1～3においては、金属蒸着膜は形成していない。また、比較例4においては、LEDチップ搭載面の表面粗さを過大に調整した以外は実施例1と同様の工程で調製したものである。

#### 【0029】

さらに、上記各基板表面に同一仕様の青色発光LEDチップを搭載し、基板背面(裏面)側のランドに通電端子を接合し、ビアホールを介してLEDチップに通電するように配線を接続した。最後に、搭載したLEDチップを覆うように黄色発光蛍光体(YAG)を装着することにより、白色光を発する各実施例および比較例に係る発光装置を製造した。

#### 【0030】

こうして調製された各実施例に係る発光装置10は、図1および図2に示すように、熱伝導率が高い窒化アルミニウム (AlN) 基板11と、このAlN基板11の表面に搭載された青色発光LEDチップ12と、このLEDチップ12表面を覆うように装着された黄色発光蛍光体13と、上記AlN基板11の表面に形成された金属蒸着膜14と、AlN基板11を厚さ方向に貫通するように形成されたビアホール15と、このビアホール15の、基板背面側の端部に形成されたランド16とを備え、AlN基板11の背面(裏面)側のランド16に通電端子を接合し、ビアホール15を介してLEDチップ12に通電するように配線を接続した構造を有する。

#### 【0031】

上記のように調製した各実施例および比較例に係る発光装置について、各基板の仕様(材料種類、厚さ、熱伝導率)、LEDチップ搭載面の表面粗さ、金属蒸着膜の仕様(種類、厚さ、光反射率)をまとめるとともに、各LEDチップへの通電量を徐々に増加せしめ

、LEDチップが破壊されずに安定的に発光する範囲で最大の電流値を測定した。また、各発光装置における最大の発光強度を測定して表1に示す結果を得た。なお、発光強度はアルミナ ( $Al_2O_3$ ) 基板を使用した比較例2に係る発光装置の発光強度を100% (基準値) として相対的に表示した。

【表1】

試料No.	基板		LED搭載面 表面粗さRa ( $\mu m$ )	金属蒸着膜			通電可能な 最大電流値 (mA)	発光強度 (相対値) (%)
	材料種類	厚さ (mm)		熱伝導率 (W/m $\cdot$ K)	種類	厚さ ( $\mu m$ )	光反射率 (%)	
実施例1	AlN	0.625	180	0.1	Ag	3	95	2040
実施例2	AlN	0.625	180	0.1	Al	3	92	1910
実施例3	AlN	0.625	180	0.2	Ag	3	95	1830
実施例4	AlN	0.625	180	0.2	Al	3	92	1720
実施例5	AlN	0.625	180	0.3	Ag	3	95	1610
実施例6	AlN	0.625	180	0.3	Al	3	92	1520
比較例1	樹脂	1.2	0.2	0.2	-	-	-	10
比較例2	$Al_2O_3$	0.625	17	0.2	-	-	-	100(基準値)
比較例3	AlN	0.625	180	0.1	-	-	-	310
比較例4	AlN	0.625	180	0.5	Ag	3	95	1320

## 【0032】

上記表1に示す結果から明らかなように、青色発光LEDチップ12を搭載する基板 (LED用パッケージ) として、熱伝導率が高い窒化アルミニウム (AlN) 基板11を使用し、LEDチップ搭載面を鏡面研磨し、さらにAlN基板11表面に所定の金属蒸着膜を形成した各実施例に係る発光装置においては、放熱性が改善されているため、通電可能な最大電流値を大幅に高めることができ、発光強度を飛躍的に増大させることが可能になった。

## 【0033】

一方、LEDチップ12の搭載基板として、樹脂基板やアルミナ ( $Al_2O_3$ ) 基板を



使用した比較例 1, 2 に係る発光装置においては、放熱性が低いために通電可能な電力が制限されるため、最大電流値は相対的に低く発光強度についての改善も期待できないことが再確認できた。また、AlN 基板を用いても金属蒸着膜を形成しない比較例 3 においては、通電可能な電流値は高いが、発光が AlN 基板へ吸収される割合が増加し発光強度が低下した。さらに、LED チップ搭載面の表面粗さが過大である比較例 4 においても、チップの接合面における光の乱反射・吸収が多くなり、発光強度が低下した。

#### 【0034】

図 3 は実施例 1 および比較例 1 ~ 2 に係る発光装置における通電電流値と発光効率との関係を示すグラフである。LED チップ 12 の搭載基板として、窒化アルミニウム (AlN) 基板 11 を使用した実施例 1 に係る発光装置は、樹脂基板やアルミナ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 基板を使用した比較例 1, 2 に係る発光装置と比較して、通電可能な最大電流値を大幅に増加させることができ、発光強度を飛躍的に高めることが可能になった。

#### 【0035】

上記各実施例に係る発光装置 10 によれば、青色発光 LED チップ 12 を搭載する基板 (LED 用パッケージ) として、熱伝導率が高い窒化アルミニウム (AlN) のコファィア基板 (同時焼成基板) 11 を使用しているため、発光装置 10 の放熱性が大幅に高まり、通電限界量が増大し大電流を流すことが可能になるために、発光輝度を大幅に高くすることが可能になる。

#### 【0036】

また、発光素子としての青色発光 LED チップ 12 が搭載される AlN 基板 11 の表面が鏡面研磨されているために、研磨面での反射率が高くなり LED チップ 12 の接合面側からの発光が効果的に基板表面側に反射され、発光強度 (輝度) を実質的に上昇させることができる。

#### 【0037】

さらに、LED チップ 12 が搭載される窒化アルミニウム基板 11 の表面と裏面とを貫通し LED チップ 12 に裏面から導通させるためのビアホール 15 が形成され、LED チップ 12 への通電は窒化アルミニウム基板 11 の裏面からこのビアホール 15 を介して表面側の LED チップ 12 になされるため、基板 11 の表面側においてワイヤボンディング法によって配線を接続する必要がなく、配線構造が簡素化される上に、ボンディングワイヤの厚さ方向への突出がないため、発光装置 10 を薄く小型に形成できる。

#### 【0038】

また、窒化アルミニウム基板 11 の表面と裏面とを貫通し LED チップ 12 に裏面から導通させるためのビアホール 15 が形成されているため、LED チップ 12 をフリップチップ法によりフェイスダウン方式による配線が可能になる。このフェイスダウン方式による配線構造によれば、LED チップ 12 表面の任意の位置から電極を取り出すことが可能であるため、LED チップ 12 と配線導体とが最短距離で接続可能である上に、電極数が増加しても発光素子としての LED チップのサイズが大型化せず、しかも超薄型実装も可能になる。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【0039】

【図 1】本発明に係る発光装置の一実施例を示す断面図。

【図 2】図 1 に示す発光装置の平面図。

【図 3】実施例 1 および比較例 1 ~ 2 に係る発光装置における通電電流値と発光効率との関係を示すグラフ。

【図 4】従来の発光装置の構成例を示す断面図。

#### 【符号の説明】

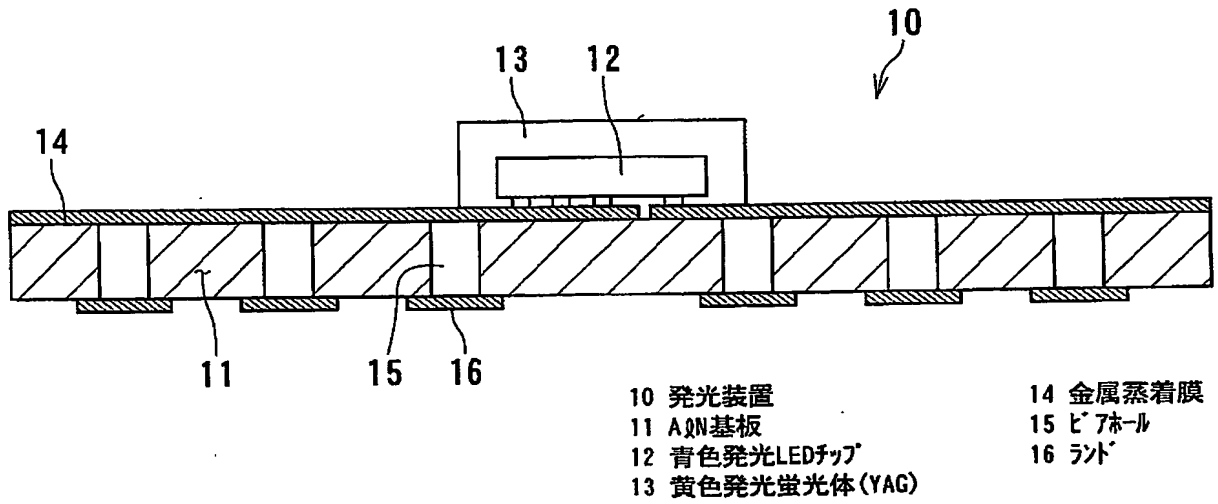
##### 【0040】

- 1, 10 発光装置
- 2 導体配線
- 3 セラミックスパッケージ

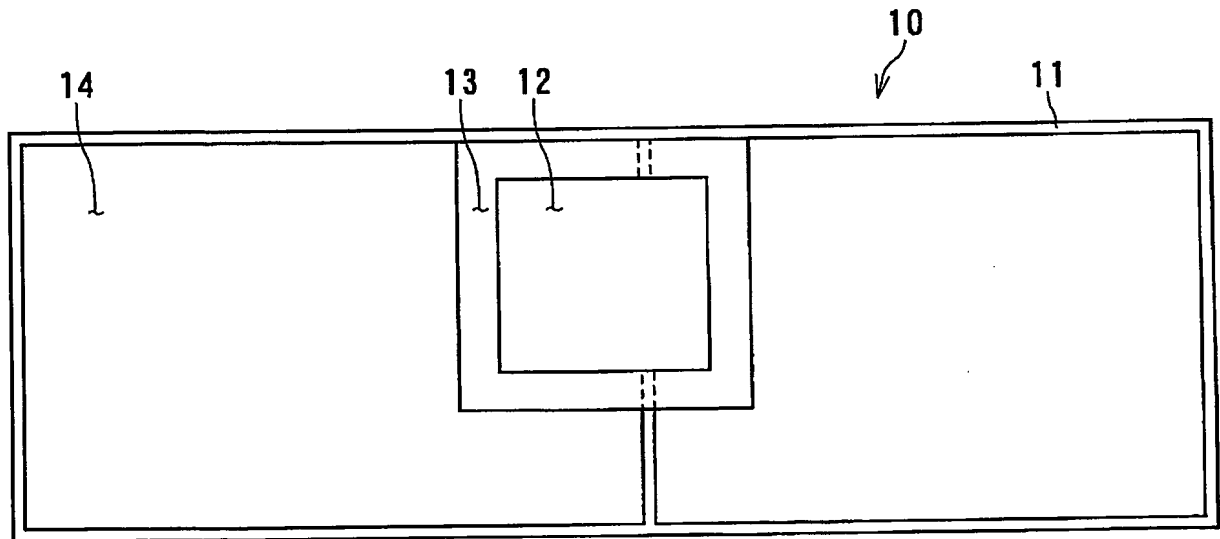
- 4   ボンディングワイヤ
- 5   LEDチップ（発光素子）
- 6, 7   金属層
- 8   樹脂モールド
- 1 1   窒化けい素基板（AlN基板）
- 1 2   発光素子（青色発光LEDチップ）
- 1 3   黄色発光蛍光体（YAG）
- 1 4   金属蒸着膜（Ag蒸着膜, Al蒸着膜）
- 1 5   ビアホール
- 1 6   ランド（端子導体部分）

【書類名】 図面

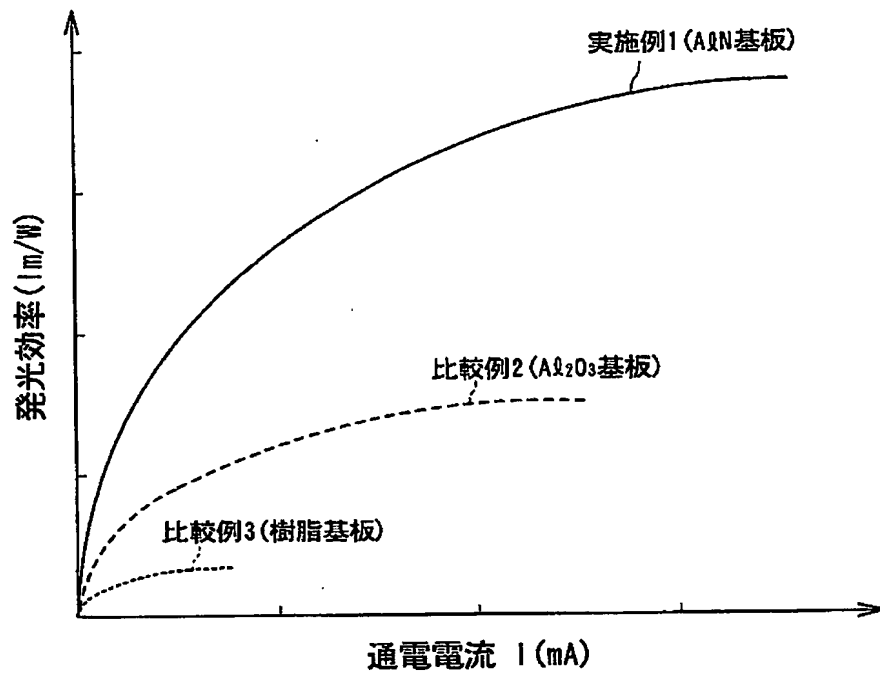
【図 1】



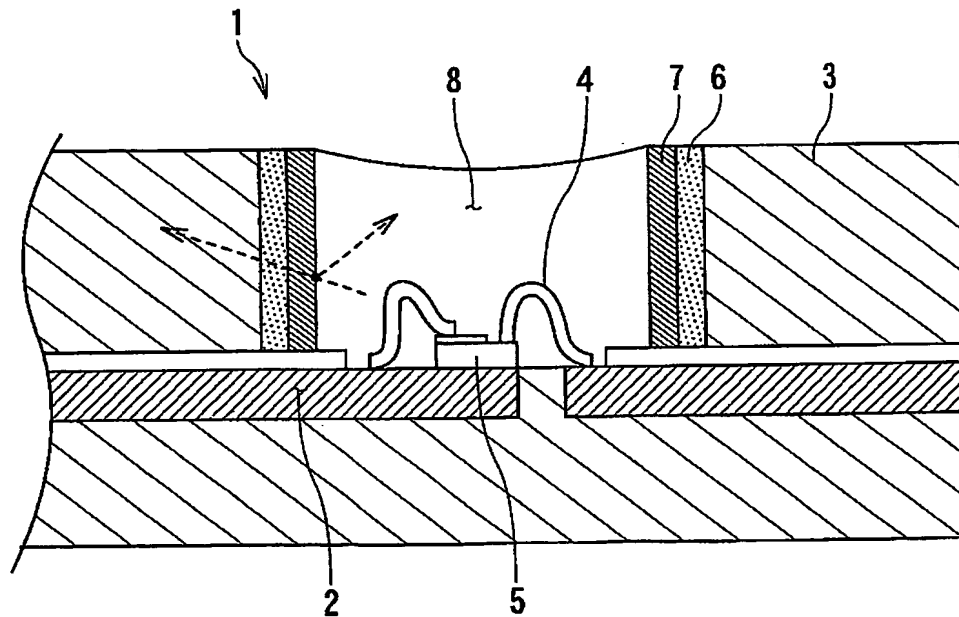
【図 2】



【図3】



【図4】



1 発光装置  
2 導体配線  
3 セラミックスパッケージ  
4 ボンディングワイヤ

5 発光素子(LEDチップ)  
6, 7 金属層  
8 樹脂モールド

## 【書類名】 要約書

## 【要約】

【課題】 小型に形成することが可能であり、また放熱性が優れ、より大きな電流を流すことができ、発光効率が高く輝度を大幅に増加させることが可能な発光装置を提供する。

【解決手段】 窒化アルミニウムから成る同時焼成基板 11 の表面に発光素子 12 が搭載された発光装置 10 であり、上記窒化アルミニウム基板 11 の発光素子 12 が搭載される表面が  $0.3 \mu\text{mRa}$  以下の表面粗さを有するように鏡面研磨されているとともに、上記発光素子 12 の周囲となる窒化アルミニウム基板 11 の表面に、発光素子 12 からの発光の反射率が 90% 以上である金属蒸着膜 14 が形成されている一方、上記発光素子 12 が搭載される窒化アルミニウム基板 11 の表面と裏面とを貫通し発光素子 12 に裏面から導通させるためのビアホール 15 が形成されていることを特徴とする発光装置 10 である。

【選択図】 図 1

【書類名】 出願人名義変更届 (一般承継)  
【整理番号】 9FB0320321  
【提出日】 平成16年 9月24日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【事件の表示】  
    【出願番号】 特願2003-341016  
【承継人】  
    【識別番号】 303058328  
    【氏名又は名称】 東芝マテリアル株式会社  
【承継人代理人】  
    【識別番号】 100078765  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 波多野 久  
【承継人代理人】  
    【識別番号】 100078802  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 関口 俊三  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 承継人であることを証明する書面 2  
    【援用の表示】 同日提出の特願 2003-341016 の出願人名義変更届に添付のものを援用する。  
    【物件名】 委任状 1  
    【援用の表示】 同日提出の特願 2003-341016 の出願人名義変更届に添付のものを援用する。

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-341016
受付番号	50401614384
書類名	出願人名義変更届 (一般承継)
担当官	笹川 友子 9482
作成日	平成 16 年 10 月 27 日

## &lt; 認定情報・付加情報 &gt;

## 【承継人】

【識別番号】	303058328
【住所又は居所】	神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地
【氏名又は名称】	東芝マテリアル株式会社

## 【承継人代理人】

申請人

【識別番号】	100078765
【住所又は居所】	東京都港区西新橋一丁目 17 番 16 号 宮田ビル 2 階 東京国際特許事務所

【氏名又は名称】	波多野 久
----------	-------

## 【承継人代理人】

【識別番号】	100078802
【住所又は居所】	東京都港区西新橋一丁目 17 番 16 号 宮田ビル 2 階 東京国際特許事務所

【氏名又は名称】	関口 俊三
----------	-------

【書類名】 出願人名義変更届  
【整理番号】 9FB0320321  
【提出日】 平成16年 9月24日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【事件の表示】  
    【出願番号】 特願2003-341016  
【承継人】  
    【識別番号】 000003078  
    【氏名又は名称】 株式会社 東芝  
【承継人代理人】  
    【識別番号】 100078765  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 波多野 久  
【承継人代理人】  
    【識別番号】 100078802  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 関口 俊三  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 011899  
    【納付金額】 4,200円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 承継人であることを証明する書面 1  
    【援用の表示】 同日提出の特願2003-341016の出願人名義変更届に添付のものを援用する  
    【物件名】 委任状 1  
    【援用の表示】 同日提出の特願2003-341016の出願人名義変更届に添付のものを援用する



## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-341016
受付番号	50401614486
書類名	出願人名義変更届
担当官	笹川 友子 9482
作成日	平成16年10月27日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

## 【承継人】

【識別番号】	000003078
【住所又は居所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【氏名又は名称】	株式会社東芝

## 【承継人代理人】

申請人

【識別番号】	100078765
【住所又は居所】	東京都港区西新橋一丁目17番16号 宮田ビル 2階 東京国際特許事務所
【氏名又は名称】	波多野 久

## 【承継人代理人】

【識別番号】	100078802
【住所又は居所】	東京都港区西新橋一丁目17番16号 宮田ビル 2階 東京国際特許事務所
【氏名又は名称】	関口 俊三

特願 2003-341016

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000003078]

1. 変更年月日

2001年 7月 2日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区芝浦一丁目1番1号

氏 名

株式会社東芝

特願 2 0 0 3 - 3 4 1 0 1 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 3 0 3 0 5 8 3 2 8 ]

1. 変更年月日

2 0 0 3 年 1 0 月 1 5 日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地

氏 名

東芝マテリアル株式会社